**2024年“IC风云榜”年度奖项申报表——**

**年度集成电路园区综合实力TOP30**

**园区信息（以下信息均为必填项）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **园区名称** |  | | |
| **成立时间** |  | | |
| **园区地址** |  | | |
| **联系人姓名** |  | **职务** |  |
| **地址** |  | **邮编** |  |
| **手机** |  | **E-mail** |  |
| **园区覆盖的重点产业链环节** | 如设计、制造、封装测试等 | | |
| **园区简介** |  | | |
| **重点集成电路企业情况** |  | | |
| **近三年园区及市级层面已出台的集成电路政策** |  | | |
| **地理位置和区位优势** |  | | |
| **人才资源** |  | | |

**注：**

**1、本表填写内容仅用于奖项评选审阅，不对外公开。**

**2、填写完毕后，请将申请表Word版发送至wangyi@ijiwei.com。**